



中华人民共和国国家标准

GB/T 13557—92

印制电路用挠性覆铜箔材料 试验方法

Test methods for flexible copper-clad
material for printed circuits

1992-07-08 发布

1993-04-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

印制电路用挠性覆铜箔材料 试验方法

GB/T 13557—92

Test methods for flexible copper-clad
material for printed circuits

本标准等效采用国际标准 IEC 249-1(1982)《印制电路用基材第一部分:试验方法》中有关内容。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了印制电路用挠性覆铜箔材料的剥离强度、弯曲疲劳和燃烧性的测试方法。

本标准适用于印制电路用挠性覆铜箔材料的剥离强度、弯曲疲劳和燃烧性的性能测试。挠性覆铜箔材料其他性能的试验方法按 GB 4722 相应的方法。

2 引用标准

GB 4722 印制电路用覆铜箔层压板试验方法

3 剥离强度试验方法

3.1 概述

本方法用以测定从挠性覆铜箔材料的基材上剥离印制导体(铜箔)所需的每单位宽度的力。试验在试样的原始状态或按 3.2~3.5 条所述的条件之一处理后进行。测试结果可用实测值表示,也可用保留百分率表示。

3.1.1 试样

试样从被试的覆铜箔材料样品上切取,长度不小于 75 mm,宽为 50 ± 1 mm,厚度为蚀刻前厚度,边缘平整。

当铜箔标称单位面积质量小于 305 g/m^2 时,可采用沉积铜的方法增加铜箔厚度,以免剥离时铜箔拉断。但沉积后铜箔单位面积质量不得超过 335 g/m^2 ,亦不应小于 275 g/m^2 。在试验报告中应说明原来铜箔的标称单位面积质量。试样按 GB 4722 中 1.1 条的方法印制如图 1 的标准试验图形。每次试验所用试样数目要至少剥离 4 条铜箔条。